

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











Das Produktsortiment umfasst folgende Ausführungen:

- 90°, liegend (horizontal) und 180°, stehend (vertikal)
- Rasthaken oben und unten (latch up / latch down)
- THT-, THR- oder SMT-Lötverfahren
- Vielzahl verschiedener Bauformen auch mit integrierten LED 's und Schirm-Kontaktfahnen
- Performance Kategorie von Cat.3 bis Cat.6
- Ausführung verpackt im Tray (TY) oder auf Rolle (Tapeon-Reel, RL)
- Kompatibel mit modularem RJ45 Stecker gemäß ANSI / TIA-1096-A und IEC 60603
- Spannungsfestigkeit ≥1500V AC RMS (2250V AC Scheitelwert) gemäß IEEE 802.3
- Spannungsfestigkeit ≥1500V AC (Scheitelwert) oder ≥1500V DC gemäß IEC 60603

Eigenschaften und Vorteile:

- Erweiterter Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C, für maximale Leistungsfähigkeit
- \bullet Verstärkte Goldschicht (30 μ ") für verbesserten Korrosionsschutz
- Mindestens 0,3mm Stand-off gewährleistet ein perfektes Lötergebnis

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Leiterplattensteckverbinder, RJ45 Buchsen, Cat. 5 , THT/THR-Lötanschluss, 90°, Riegel-Option: oben, Schirm tabs: keine, 3080 μ " / \geq 30 μ " , LED: Nein, Polzahl: 8, Tape
BestNr.	<u>2638490000</u>
Art	RJ45C5 R1U 2.8N4N RL
GTIN (EAN)	4050118657104
VPE	200 Stück
Verpackung	Tape



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	15,7 mm	Tiefe (inch)	0,618 inch
Höhe	13,11 mm	Höhe (inch)	0,516 inch
Breite	16,4 mm	Breite (inch)	0,646 inch
Nettogewicht	7,095 g		

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ	Nennspannung	125 V
Nennstrom	1.5 A	PoE / PoE+	gemäß IEEE 802.3at
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	1000 V DC	Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm	1500 V DC

Normen

Steckverbinder Norm	IEC 60603-7
Steckverbillider Mollill	ILC 00003-7

Systemkennwerte

Abgangswinkel	90°	Anschlussart	Lötanschluss
Kategorie	Cat. 5	LED	Nein
Leistungs-Kategorie	Cat. 5	Lötstift-Abmessungen	oktogonal
Lötstiftlänge (I)	2,8 mm	Lötstiftposition-Toleranz	± 0,1 mm
Lötverfahren	Reflow-Löten, Handlöten, Wellenlöten	Montage auf der Leiterplatte	THT/THR-Lötanschluss
Polzahl	8	Produktfamilie	OMINMATE Data – Modu- lare RJ45-Buchse
Raster in Zoll (P)	0,04 "	Raster in mm (P)	1,02 mm
Riegel-Option	oben	Schirm tabs	keine
Schirmmaterial	Messing, vernickelt	Schirmoberfläche	vernickelt
Schirmung	Ja	Schutzart	IP20
Steckzyklen	750		

Werkstoffdaten

Isolierstoff	PA 9T	Farbe	schwarz, cyan
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011, RAL 5018	Isolierstoffgruppe	II
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ	Moisture Level (MSL)	1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Kontaktbasismaterial	Phospor-Bronze Legierung
Kontaktmaterial	Cu-leg	Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Schichtaufbau - Lötanschluss	3080 μ"	Schichtaufbau - Steckkontakt	3080 μ" / ≥ 30 μ"
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Lagertemperatur, max.	85 °C
Betriebstemperatur, min.	-40 °C	Betriebstemperatur, max.	85 °C

Verpackungen

Verpackung	Tape	VPE Länge	357 mm
VPE Breite	354 mm	VPE Höhe	126 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01
ECLASS 14.0	27-46-02-01	ECLASS 15.0	27-46-02-01

Erstellungs-Datum 25. Juni 2025 07:18:28 MESZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform	
Umweltanforderungen		
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme	
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%	
Downloads Zulassung / Zertifikat / Konformit	ätedo-	
kument	Certificate of Compliance	
Engineering-Daten	CAD data – STEP	
Technische Dokumentation	Customer Drawing Customer Drawing Customer Drawing	
Kataloge	Catalogues in PDF-format	



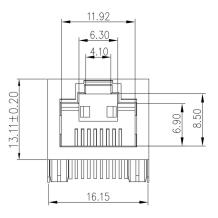
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

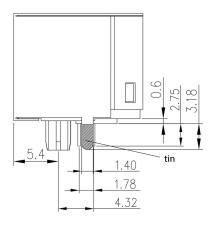
www.weidmueller.com

Zeichnungen

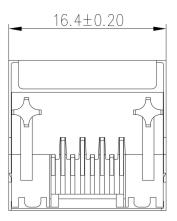
Maßzeichnung



Maßzeichnung



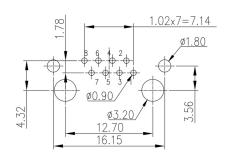
Maßzeichnung



Maßzeichnung



Leiterplatten-Layout



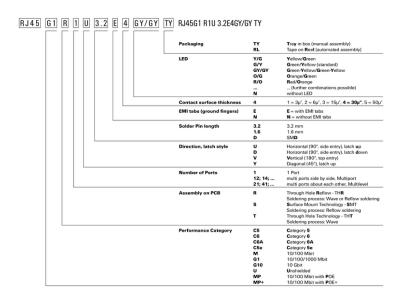


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



Legende



Empfohlene Wellen-Lötprofile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Einzelwelle:



Doppelwelle:



Wellen-Lötprofile

Bedrahtete Anschlusselemente sind in Anlehnung an die Norm DIN EN 61760-1 zu verarbeiten. Anbei zwei Empfehlungen für praxisbezoge Wellenlötprofile, mit denen Leiterplattenanschlussklemmen und Steckverbinder von Weidmüller qualifiziert sind.

Bei der Wahl eines passenden Profils für Ihre Anwendung sind unteranderem folgende Faktoren zu beachten:

- Stärke der Leiterplatte
- Cu-Anteile in den Lagen
- Ein-/Beidseitige Bestückung
- Produktspektrum
- Aufheiz- und Abkühlrate

Die Einzel- und Doppelwelle zeigt jeweils den empfohlenen Verarbeitungsbereich inkl. der maximalen Löttemperatur von 260°C. In der Praxis liegt die maximale Löttemperatur sehr häufig weit unter dem o.g. Maximalprofil.





Empfohlenes Reflow-Lötprofil

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com



Reflow Lötprofil

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt ≤ +3 K/s. Parallel dazu wird die Lotpaste 'aktiviert'. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüsse auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei ≥ -6 K/s härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.